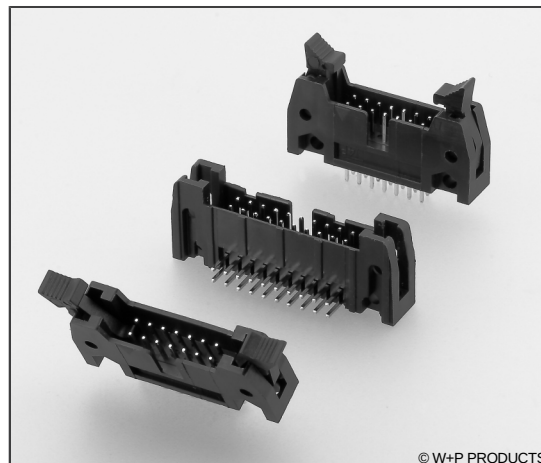


Technische Daten / Technical Data

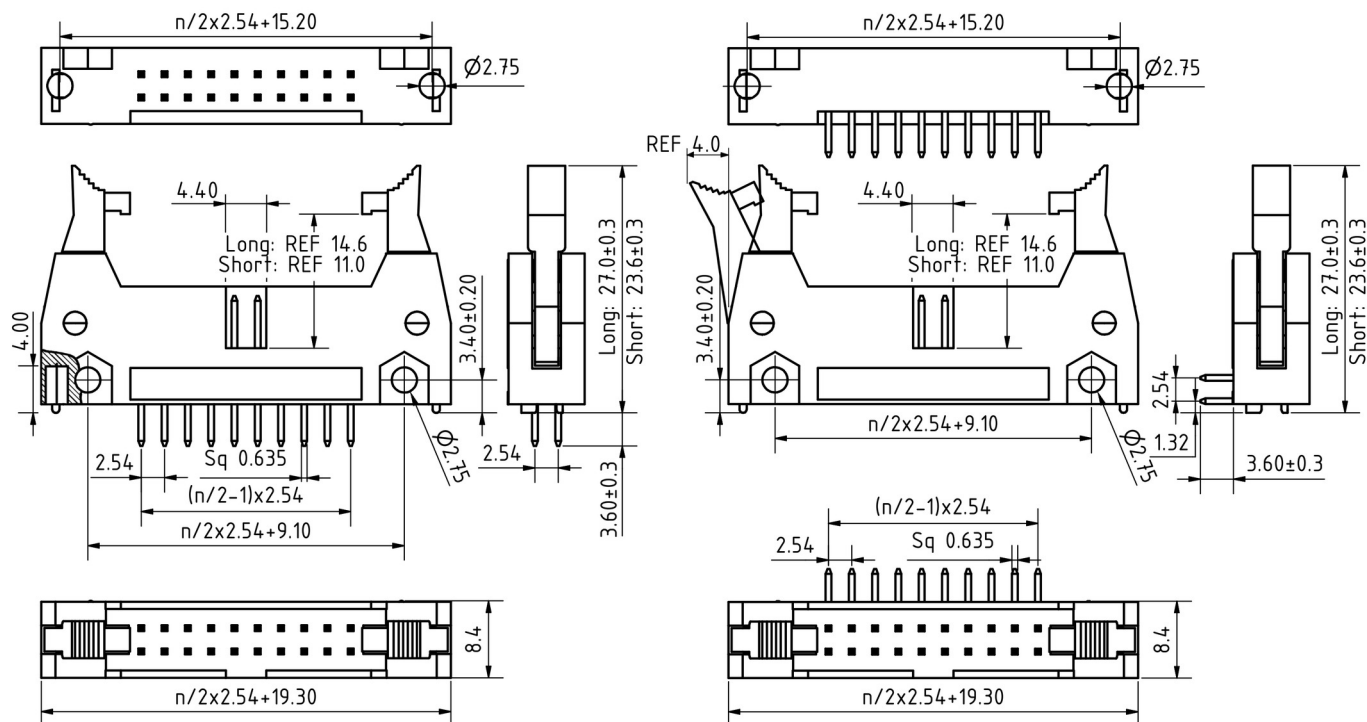
Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
<i>Insulator</i>	<i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial	Vierkantstift 0,635mm, Kupferlegierung
<i>Contact Material</i>	<i>Square pin 0.635mm, copper alloy</i>
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni
<i>Contact Surface</i>	<i>Acc. to options (see below), over Ni</i>
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
<i>Contact Resistance</i>	<i>< 20 mΩ</i>
Isolationswiderstand	> 5 GΩ
<i>Insulation Resistance</i>	<i>> 5 GΩ</i>
Spannungsfestigkeit	1000 V AC
<i>Test Voltage</i>	<i>1000 V AC</i>
Nennspannung	250 V AC
<i>Voltage Rating</i>	<i>250 V AC</i>
Nennstrom	3 A
<i>Current Rating</i>	<i>3 A</i>
Temperaturbereich	-55 °C ... +105 °C
<i>Temperature Range</i>	<i>-55 °C ... +105 °C</i>
Verarbeitung	Wellenlötverfahren (auf Anfrage auch für Reflow-Lötverf.)
<i>Processing</i>	<i>Wave soldering (on request for reflow soldering)</i>



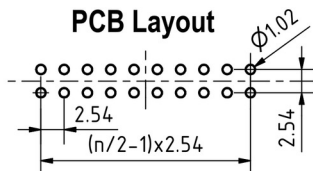
© W+P PRODUCTS

Passende Gegenstecker:
Compatible Connectors:

141



PCB Layout



Series	Contacts*	Type*	Latches*	Plating*	Colour (Optional)*	Material (Optional)*
138	26	1	00	60	..	..
	10/14/16/20/ 24/26/30/34/ 40/44/50/60/ 64	1 Gerade <i>Straight</i> 2 Gewinkelt <i>Right-angled</i>	00 Ohne Hebel <i>W/o latches</i> 10 Kurze Hebel <i>Short latches</i> 20 Lange Hebel für Gegenstecker mit Zugentlastung <i>Long Latches for mating connectors with strain relief</i>	00 Vergoldet <i>Gold plated</i> 60 Sel. Au/Sn <i>Duplex Plating</i>	[] Standard: schwarz <i>Standard: black</i> 6 Grau <i>Grey</i>	[] Standard (Wave Soldering) <i>Standard (Wave Soldering)</i> HT Hi-Temp (Reflow Soldering) <i>HT Hi-Temp (Reflow Soldering)</i>

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* *This is an **order example** -
please replace by your specifications.*

Design- und technische Änderungen auch ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and/or technical specifications may change without prior notice.

W+P
WE CONNECT IT

(+49) 5223 98507-0
sales@wppro.com

Informationen zum Wellen-Lötverfahren

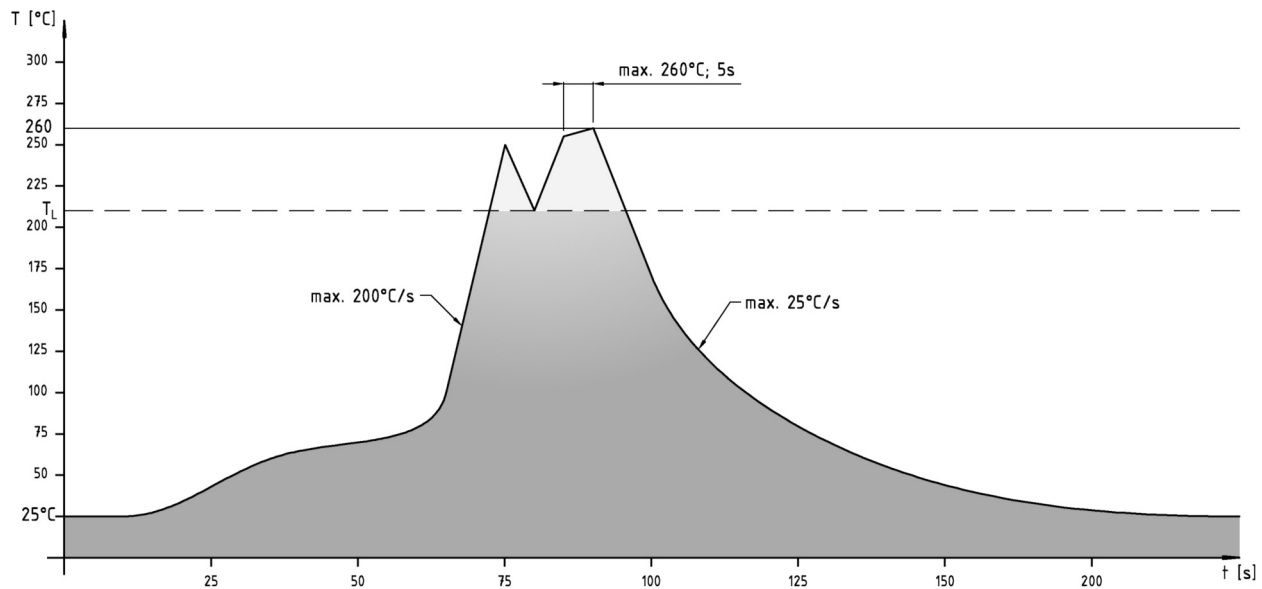
Wave Soldering Information

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.

Empfohlenes Wellenlötprofil:



Informationen zum Reflow-Lötverfahren Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150 °C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	217 °C
Verweildauer oberhalb T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150 °C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature T_L	217 °C
Duration above T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature T_P	260±5 °C
Duration Peak Temperature	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	max. 8min

